檔　　號:
保存年限:

中華創新發明學會 函

地址：10595臺北市松山區復興北路1號6樓之4
承辦人：中華創新發明學會
電話：02-2778-2688

受文者：東吳大學

發文日期：中華民國115年5月12日
發文字號：中創發字第1150000013號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：2026香港創新科技國際發明展參展辦法 (0000013A00_ATTCH1.pdf)

裝

主旨：敬邀 貴校參加「2026第十三屆香港創新科技國際發明展」，為國為校爭取最高榮譽，詳如說明，請查照。

說明：

一、「2026第十三屆香港創新科技國際發明展」，預定於115年11月25日(三)舉行，即日起報名至115年10月02(五)止。

訂

二、「2026第十三屆香港創新科技國際發明展」，為線上展，競賽以文件審查為主，本活動由中華創新發明學會及IAIA國際創新發明聯盟總會主辦，敬邀貴校師生踴躍參加。

三、本比賽為線上活動，檢附參展辦法，相關附件資料已同步公佈在官網，歡迎至官網www.innosociety.org下載，並將報名文件E-mail至choice@mail2000.com.tw

線

正本：114全國大學
副本：電子公文交換章 2026/05/12 11:50:45

東吳大學
1150004235　115/05/12